

**Proyecto: Aislación USB**

**Autor: Marcos Darino**

**Revisado por: Francisco Galli**

**Revisión: 00**

## **ESQUEMATICO**

---

- R1 y R7 se sugiere usar algún múltiplo de la serie de tolerancia de 5% o 10%. 420e o 390e
- Respecto a los desacoples del ADuM5000 sugieren parejas de capacitores de 100nF y 10uF de baja ESR. Se sugiere reemplazar C5, C6, C13 y C14 por MLCC de 10uF.
- Sugieren unir en el ADuM5000 pines 10 y 16 pese a que estén conectados internamente.
- Se sugiere unir pines 2 con 3 y 14 con 15, para mejorar el path de ground en el layout del pcb del ADuM5000.
- R8, R9, R11, R12, R13 pueden omitirse.
- Es algo confusa la conexión de los capacitores C22 y C25, se sugiere modificar el dibujo del ADuM4160 para aclarar el esquemático.
- Detalle fino, darle simetría a la hoja que contiene el ADuM4160 respecto de las líneas de aislación.

**-El diodo D2 podría omitirse. – Agregar diodo contra inversión de polaridad**

## **PCB**

---

- El modelo 3D del diodo D2 está al revés.
- Cuanta corriente se pretende extraer de la fuente externa? No entraría un DPAK?
- Veo muy justos los pads de TRx,U1,U5 . Revisar el layout recomendado de los TRx (pads de 0.35x0.9 mm). De los U1 y U5, los pads chicos, la dimensión de 0.54mm tiene que ser almenos de 0.6mm
- Si el montaje es con tornillo y tuercas, la posición de H3 dificultaría el mismo.